Pâte à souder SB58-COSMO-NH-T4

GENMA EUROPE

Description du produit

Pâte à souder GENMA – notre pâte à souder éprouvée COSMO existe maintenant également avec alliage à bas point de fusion. La pâte à souder SB58-COSMO-NH-T4 est une pâte à souder basse température. En raison du point de fusion bas, la pâte à souder est utilisée lorsqu'un deuxième processus de brasage par refusion est nécessaire, pour des composants très sensibles à la température ou pour économiser de l'énergie en raison de la température de processus plus basse. La pâte à souder convainc avec son mouillage exceptionnel, sa très bonne imprimabilité, sa haute définition des contours, sa longue durée de vie et sa force d'adhérence constante lors de l'assemblage. Le très bon mouillage également sur des surfaces dures assure une brasure parfaite sur les BGA. La viscosité exceptionnellement stable permet un stockage jusqu'à 12 mois, ce qui simplifie la disposition pour vous. De plus, la pâte à souder peut être transportée non refroidie. Il n'est pas nécessaire de nettoyer après le soudage. La pâte à souder peut être soudée sous air ou sous gaz inerte.

Propriétés techniques

	Valeur spécifique	Méthode d'essai
Alliage (wt %)	Sn 42 / Bi 58	
Plage de fusion (°C)	138 - 138	IEC61189-11
Taille de la poudre (µm)	22 - 38, type 4	IPC-TM-650-2.2.14.2
Viscosité (Pas)	180 ± 30	IPC-TM-650-2.4.34.3
Teneur en flux (%)	11 ± 0.5	IPC-TM-650-2.3.34.1
Type de flux	ROL0, no clean	IPC-J-STD-004B
Grille d'application (mm)	0,4	
Teneur en halogène (%)	<0.01	IPC-TM-650-2.3.35
Fonctionnement à l'impression (mm)	≤ 0,2	IPC-TM-650-2.4.35
Fonctionnement à l'impression (mm)	≤ 0,3	IPC-TM-650-2.4.35 (120°C / 60sec)
Résistance d'isolation (Ω)	> 1 x 10^{11} (40°C 90 % humidité relative)	IPC-TM-650-2.6.3.3
Résistance d'isolation (Ω)	> 5 x 10^{8} (85°C 85 % humidité relative)	IPC-TM-650-2.6.3.3
Test de migration	Pas de migration	IPC-TM-650-2.6.14.1
Test de niveau de cuivre	Pas de corrosion	IPC-TM-650-2.3.32
Unité d'emballage	Dose (0,5 kg) cartouche Semco (0,65 kg, 1,2 kg)	
Durée de conservation minimum	12 mois à 0 - 10 °C, 3 mois < 25 °C, 1 mois < 35 °C	
Transport	sans refroidissement	
Trempe de la pâte à souder	Amener à température ambiante à temps avant ouverture pour éviter la condensation.	
Vitesse d'impression recommandée (mm/s)	20 - 50	

GENMA Europe GmbH | Robert-Bosch-Str. 18 | 71394 Kernen i. R. Germany | Phone +49 7151 206610 | team@genma.eu | www.genma.eu

	Valeur spécifique	Méthode d'essai
Température recommandée lors de l'impression (°C)	25 ± 3	
Humidité relative recommandée en % à l'impression	50 ± 20	

Conformité

Au 13.11.2025

Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU et annexe 2015/863/EU.

Ne contient aucune substance (liste – SVHC) supérieure à la valeur limite (0,1 %) conformément au règlement REACH CE no 1907/2006.

Ne contient aucune substance conformément à la Toxic Substance Control Act (TSCA) de l'Environmental Protection Agency des États-Unis.

Ne contient aucune substance conformément au règlement POP UE 2019/1021.

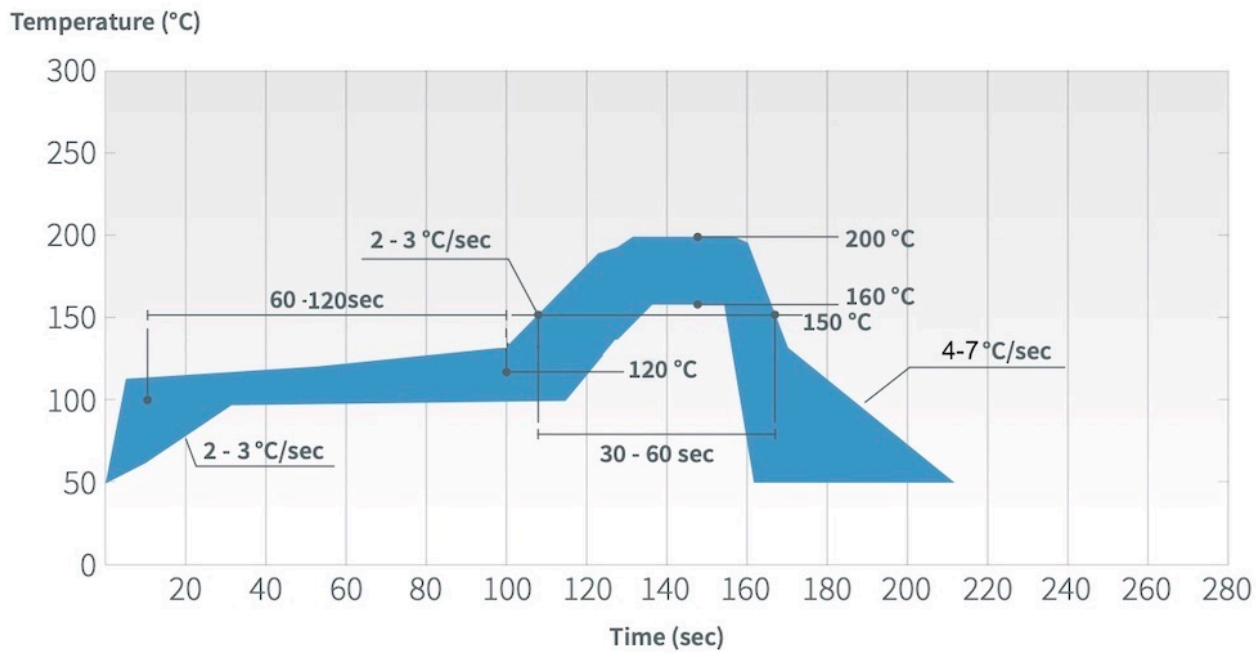
Ne contient pas de composés alkyles per- et polyfluorés (PFAS).

Ne contient pas de phtalates ni latex.

Ne contient aucune substance interdite par la Proposition 65 de Californie.

GENMA Europe GmbH | Robert-Bosch-Str. 18 | 71394 Kernen i. R. Germany | Phone +49 7151 206610 | team@genma.eu | www.genma.eu

Profil de flux recommandé



Préchauffage

L'élévation de la température jusqu'à la zone de préchauffage devrait être de 2 – 3 °C/seconde. Un accroissement trop rapide de la température peut conduire à une dispersion de la pâte à souder.

Dans un but d'atteindre une dissémination aussi réduite que possible de la température (⊿t) sur la plaquette de circuit imprimé, la température dans la zone de préchauffage devrait être de 120 – 150 °C et la durée de préchauffage de 60 à 120 secondes. En cas de température inférieure et de durée plus réduite, la dissémination de la température (⊿t) sur la plaquette de circuit imprimé est trop importante. En cas de température supérieure et de durée plus importante, les activateurs sont perdus, ce qui peut conduire à ce que la pâte à souder ne fonde pas.

Pic de reflux

Nous vous recommandons de maintenir dans la mesure du possible la température au-dessus de 160°C pendant 20 – 150 secondes.

Refroidissement

La vitesse de refroidissement devrait se trouver entre 4 – 7°C/seconde. Un refroidissement trop lent peut conduire à un glissement ou un redressement des éléments de construction et réduire l'épaisseur de la connexion soudée. Un refroidissement au contraire trop rapide peut endommager les éléments de construction par un choc thermique.

GENMA Europe GmbH | Robert-Bosch-Str. 18 | 71394 Kernen i. R. Germany | Phone +49 7151 206610 | team@genma.eu | www.genma.eu